

PALTEK

(証券コード:7587)

2019年12月期 第3四半期 決算説明資料

2019.11.7 (木)

© 2019 PALTEK Corporation. All rights reserved.

本資料取り扱い上の注意点

本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したもので、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

なお、本資料においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。

また、実際の業績に影響を与えうるリスクや不確実な要素には、以下のようなものが含まれます。

- ① 国内エレクトロニクス業界の急激な景気変動や需要動向の変化
- ② 仕入先の代理店政策の見直しや再編等により取引関係の継続が困難となった場合
- ③ 不測の事態による当社グループの情報資産が流出した場合
- ④ 為替相場の急激な変動
- ⑤ 新規仕入先商品の立ち上がりの遅れが生じた場合
- ⑥ 顧客の日本国内での製品開発案件が更に海外へシフトし、当社グループの販売活動が及ばない地域へ移管された場合

- ① **2019年12月期 第3四半期
業績結果**
- ② **2019年12月期 業績予想**
- ③ **今後に向けた取り組み**

- ① **2019年12月期 第3四半期
業績結果**

(百万円)	2018年第3四半期		2019年第3四半期		増減	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
売上高	22,841	100.0%	22,463	100.0%	△377	△1.7%
売上総利益	2,835	12.4%	2,550	11.4%	△284	△10.0%
販管費	2,363	10.3%	2,494	11.1%	131	5.6%
営業利益	472	2.1%	56	0.2%	△416	△88.1%
経常利益	217	1.0%	△16	△0.1%	△234	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	119	0.5%	△42	△0.2%	△162	—
1株当たり四半期純利益	10.93円	—	△3.88円	—	△14.81円	—

主な増減要因

- 売上総利益の減少は、売上高の減少および売上総利益率の低下による
- 営業利益の減少は、売上総利益の減少および新規事業への投資などによる販管費の増加による
- 経常利益の減少は、為替差損が発生したことによる

(百万円)	2018年第3四半期		2019年第3四半期		増減	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
半導体	21,461	94.0%	20,390	90.8%	△1,071	△5.0%
デザインサービス	1,246	5.4%	1,466	6.5%	219	17.6%
ソリューション	133	0.6%	607	2.7%	473	355.3%
売上高合計	22,841	100.0%	22,463	100.0%	△377	△1.7%

主な増減要因

- 半導体事業は、医療機器や計測機器向けなどにFPGAが増加した一方で、海外の携帯情報端末向けメモリ製品が大幅に減少したことなどを受け減少
- デザインサービス事業は、産業機器、航空/宇宙分野向けなどが増加
- ソリューション事業は、映像配信システムおよび産業向けIoTシステムの販売が増加

■ 売上総利益率の低下は、以下の2つが要因

- ドル円相場の変動により、仕入先に対して保有する仕入値引ドル建債権の評価額は変動
売上総利益に対する影響額は、
2018年第3四半期では△94百万円（△0.4%分）
2019年第3四半期では△295百万円（△1.3%分）

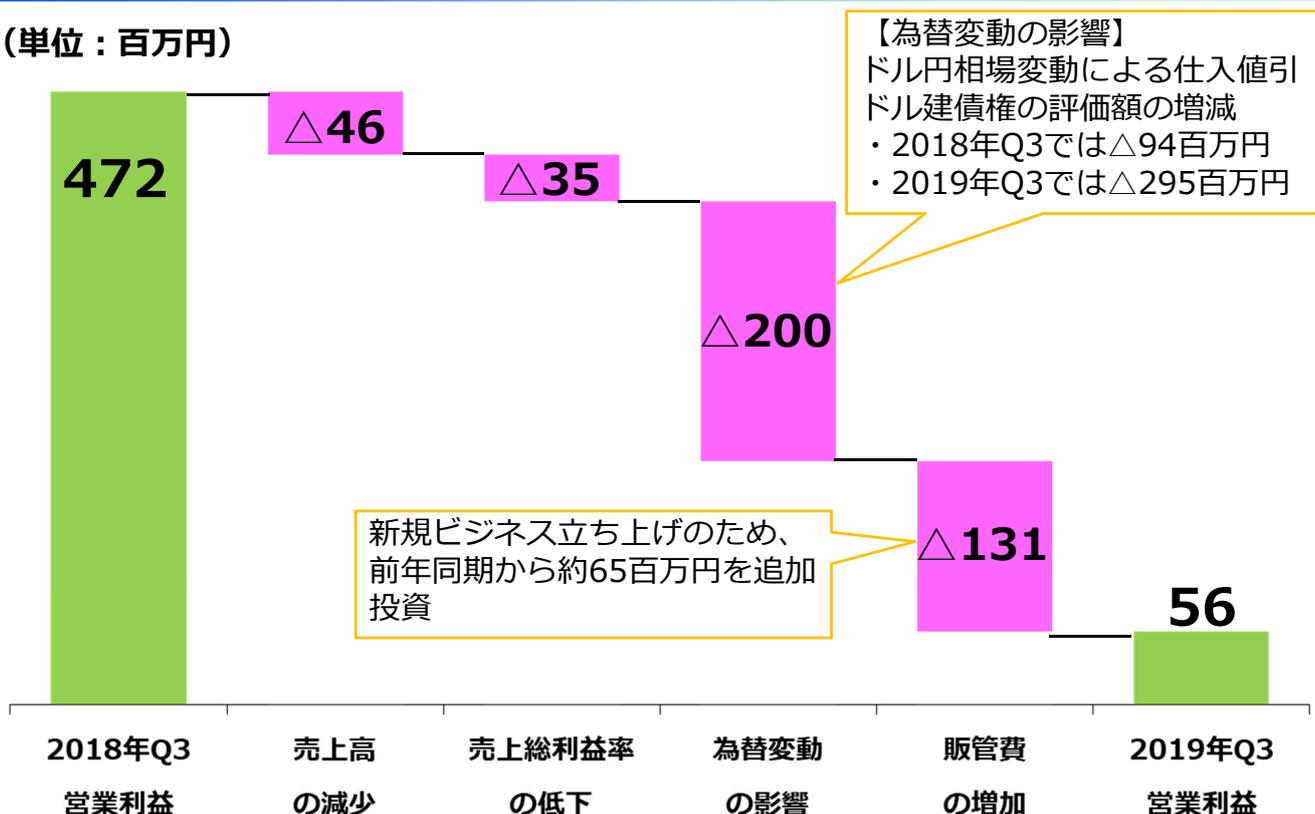
(百万円)	2018年第3四半期		2019年第3四半期	
	金額	対売上比率	金額	対売上比率
売上総利益	2,835	12.4%	2,550	11.4%
(うち為替の影響額)	△94	△0.4%	△295	△1.3%
売上総利益 (為替の影響を排除)	2,930	12.8%	2,846	12.7%

- 半導体事業において、FPGAビジネスで取引形態の変更により、主要大手顧客(一部)の利益率が低下

7

© 2019 PALTEK Corporation. All rights reserved.

(単位：百万円)

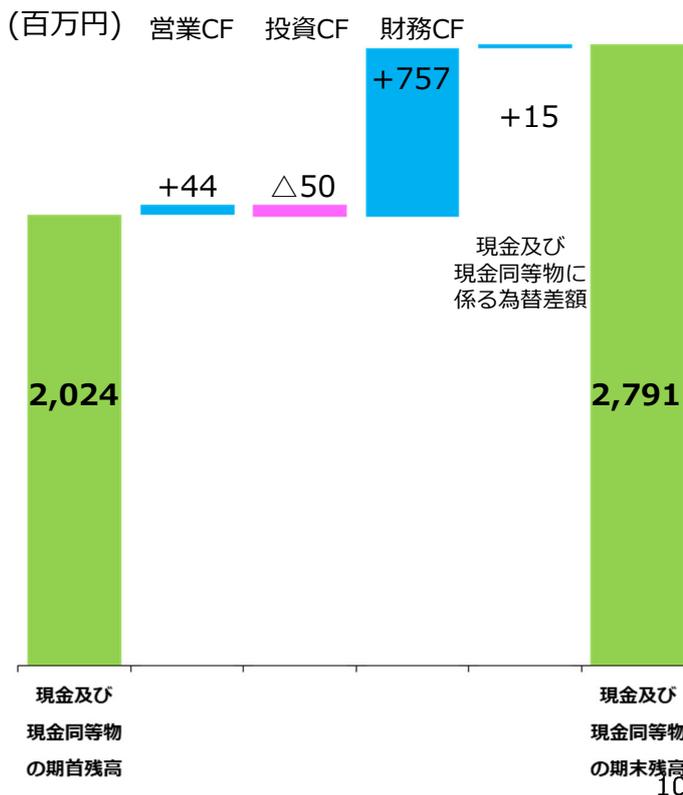


8

© 2019 PALTEK Corporation. All rights reserved.

	(百万円)	2018.12	2019.09	増減額	主な増減理由
資産内訳	現金及び預金	2,024	2,791	766	
	売上債権	6,354	6,951	596	
	商品	3,126	3,600	474	
	その他流動資産	1,844	1,423	△420	未収入金が減少
	固定資産	497	625	128	
資産合計		13,846	15,392	1,545	
負債純資産内訳	仕入債務	945	1,380	434	
	短期借入金	2,010	2,880	870	
	その他流動負債	1,091	1,523	431	未払金が増加
	固定負債	256	220	△36	
	純資産	9,542	9,388	△154	
負債・純資産合計		13,846	15,392	1,545	

2019年第3四半期のキャッシュフローの動き



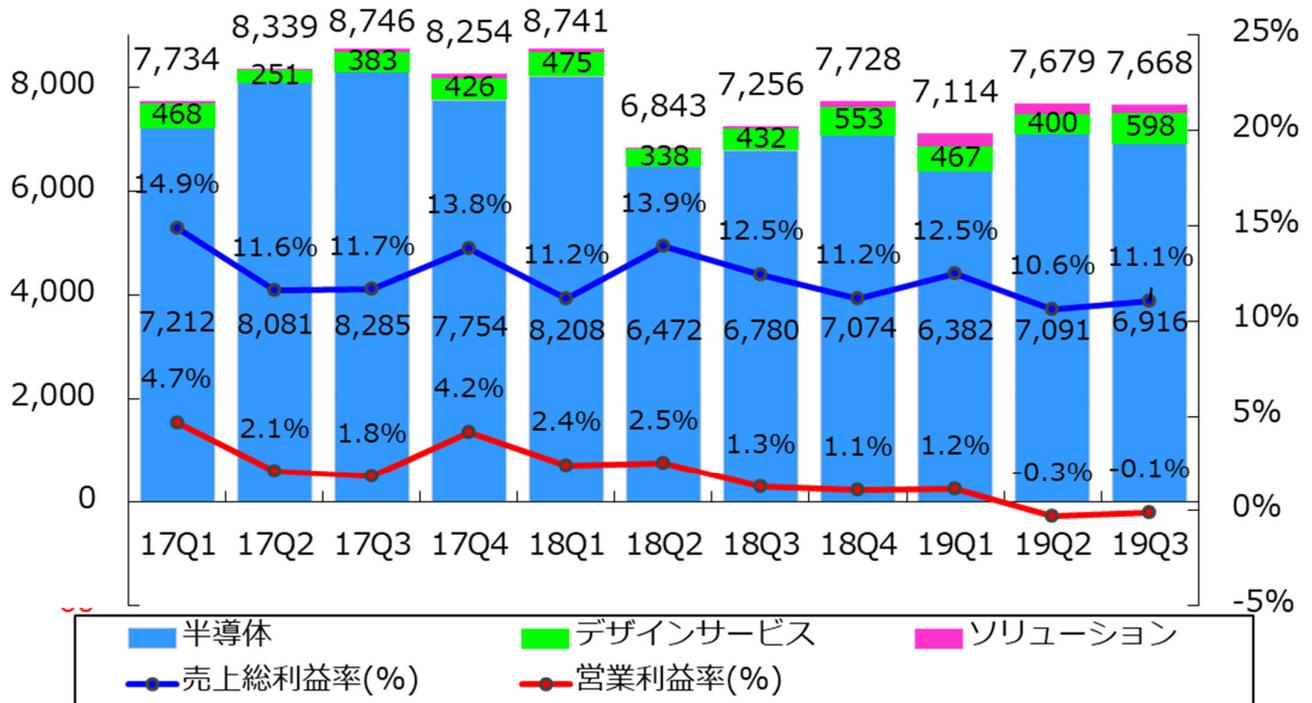
(百万円)	2018年 第3四半期	2019年 第3四半期
現金及び現金同等物の期首残高	2,178	2,024
営業CF	3,906	44
投資CF	△93	△50
財務CF	△3,676	757
現金及び現金同等物の期末残高	2,325	2,791

2019年第3四半期キャッシュフローの動き

- 【営業CF】税金等調整前四半期純損失の計上および売上債権、たな卸資産増加の一方で、仕入債務の増加および未収入金の減少により収入
- 【投資CF】有形固定資産および無形固定資産の取得により支出
- 【財務CF】配当金支払いを実施した一方で、借入れ実施などにより収入

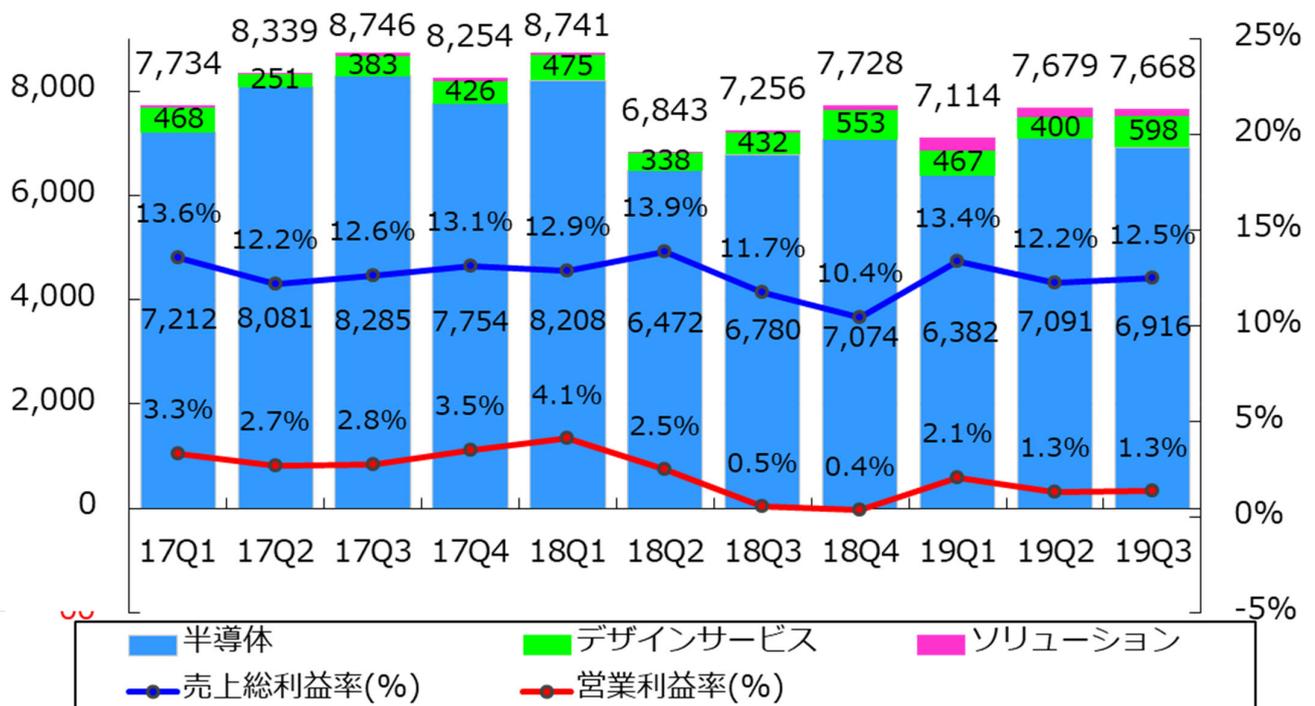
連結業績の四半期推移

(百万円)



連結業績の四半期推移 (為替の影響を除いた場合)

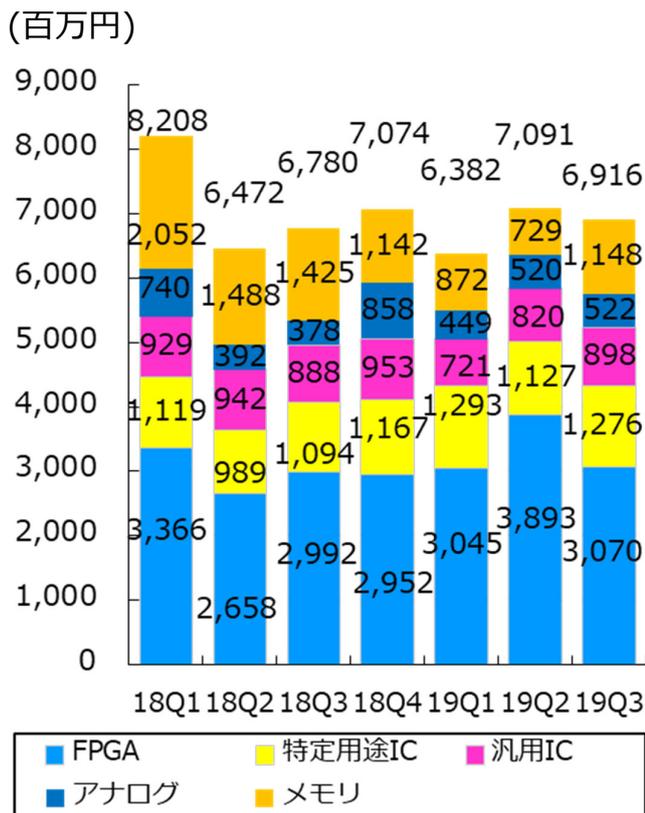
(百万円)



事業別の実績

© 2019 PALTEK Corporation. All rights reserved.

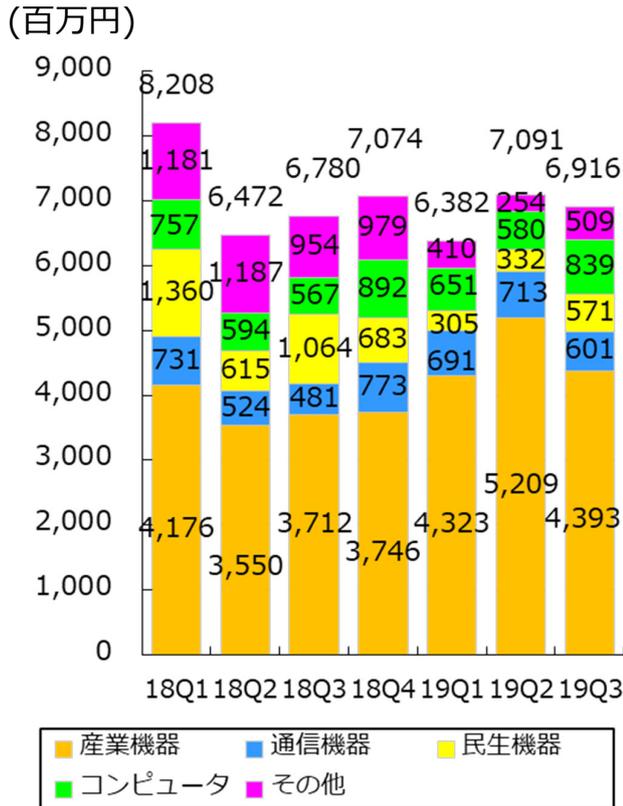
半導体事業の状況（製品別）



業績の推移

- FPGA**
前四半期から医療機器向けなどが減少
- 特定用途IC**
パソコン向けタッチパッド製品および通信インフラ向けが堅調
- 汎用IC**
ファクトリーオートメーション向けが若干増加
- アナログ**
サーバー向けなどが堅調
- メモリ**
海外の携帯情報端末向けが増加

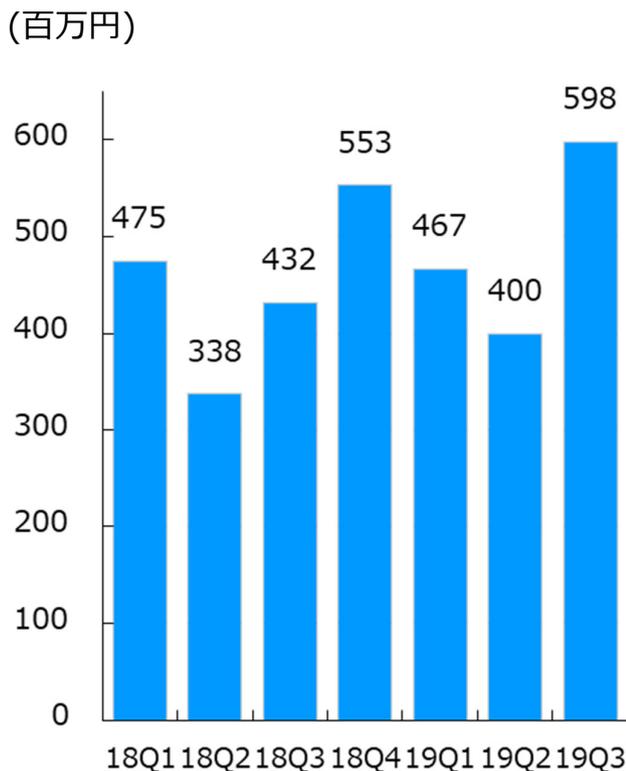
半導体事業の状況 (用途別)



業績の推移

- 産業機器
前四半期から医療機器向けなどが減少
- 通信機器
ブロードバンド通信機器向けが減少
- 民生機器
海外の携帯情報端末向けが増加
- コンピュータ
パソコン向けタッチパッド製品が増加

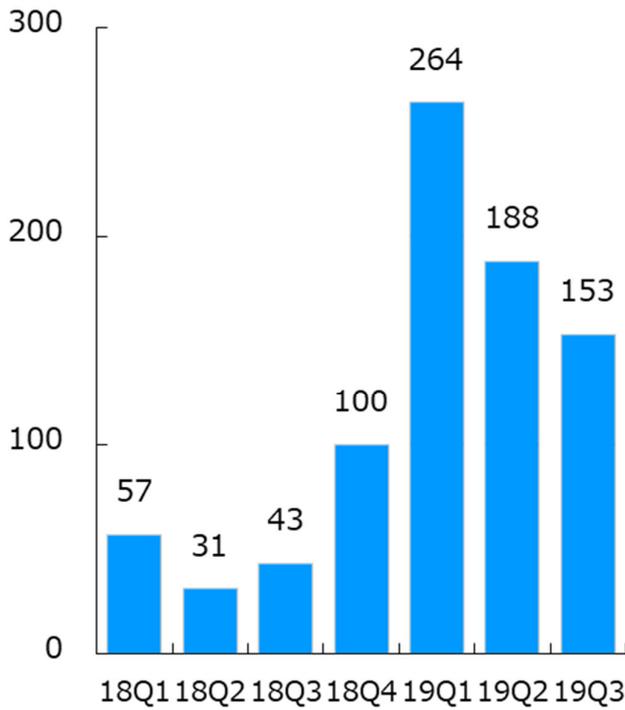
デザインサービス事業の状況



業績の推移

- 公共インフラ向けが増加

(百万円)



業績の推移

- 産業向けIoTシステムは堅調に推移
- 映像配信システムが航空/宇宙分野向けに減少

2

2019年12月期 業績予想

売上高、営業利益はほぼ想定通り推移しているものの、
経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益は
想定を下回るため業績予想を修正

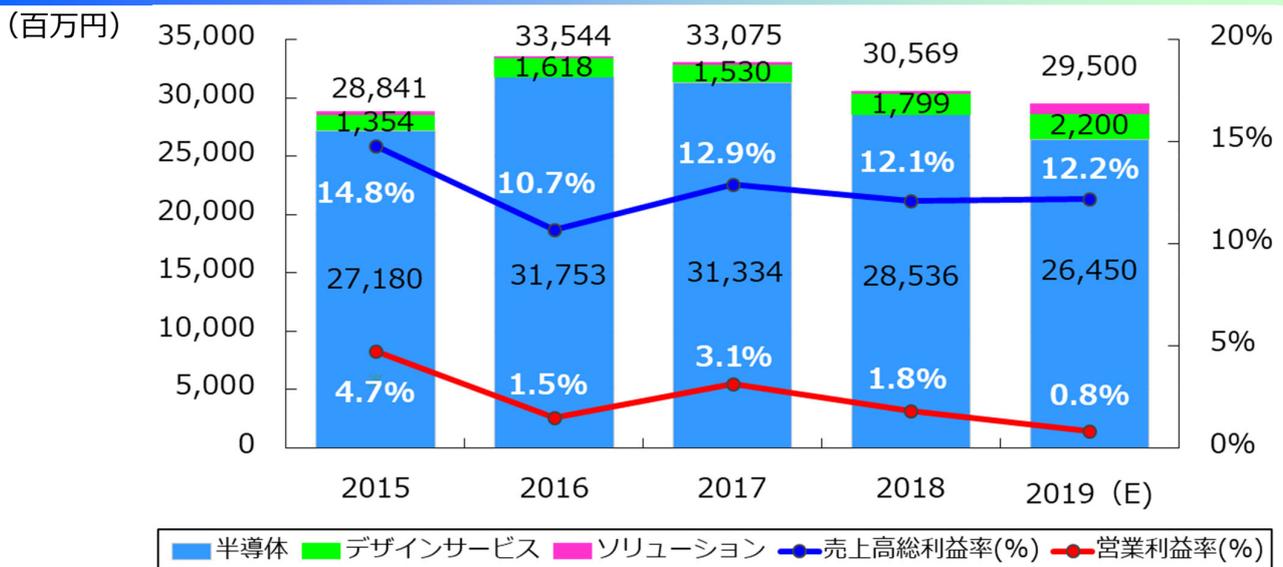
■ 通期の見通し

- 売上高、営業利益はほぼ想定通り推移
- 経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益は、第3四半期(7-9月)に為替差損57百万円が発生したことにより、想定を下回って推移するため、業績予想を修正

(百万円)	2019年12月期 修正予想 (8月5日修正)			2019年12月期 修正予想 (11月6日修正)			通期修正増減	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額	増減率
売上高	14,794	13,205	28,000	14,794	14,705	29,500	1,500	5.4%
売上総利益	1,703	1,866	3,570	1,703	1,896	3,600	30	0.8%
売上総利益率	11.5%	14.1%	12.8%	11.5%	12.9%	11.4%	-	-
販管費	1,641	1,678	3,320	1,641	1,708	3,350	30	0.9%
営業利益	61	188	250	61	188	250	-	-
営業利益率	0.4%	1.4%	0.9%	0.4%	1.3%	0.8%	-	-
経常利益	62	137	200	62	87	150	△50	△25.0%
当期純利益	23	91	115	23	51	75	△40	△34.8%

(百万円)	2018年12月期 実績			2019年12月期 予想 (11月6日修正)			通期増減	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額	増減率
売上高	15,585	14,984	30,569	14,794	14,705	29,500	△1,069	△3.5%
売上総利益	1,931	1,769	3,700	1,703	1,896	3,600	△100	△2.7%
売上総利益率	12.4%	11.8%	12.1%	11.5%	12.9%	11.4%	-	-
販管費	1,549	1,592	3,142	1,641	1,708	3,350	207	6.6%
営業利益	381	176	558	61	188	250	△308	△55.2%
営業利益率	2.4%	1.2%	1.8%	0.4%	1.3%	0.8%	-	-
経常利益	227	71	299	62	87	150	△149	△49.9%
親会社株主に帰属する当期純利益	133	52	185	23	51	75	△110	△59.6%

業績見通しの推移



- 売上高 : デザインサービス事業、ソリューション事業は増加するものの、半導体事業が減少
- 売上総利益率 : 為替の影響およびFPGAの利益率が低下することでマイナスの影響があるが、利益率の高いデザインサービス事業・ソリューション事業の売上高が増加するため売上総利益率は変わらず
- 営業利益率 : モデルベース開発、AIソリューションなどの新規事業への人材投資を継続するため、販売費及び一般管理費が増加し、営業利益率は低下

3

今後に向けた取り組み

PALTEKの方向性

■ 経営方針

- ・ ソリューションサプライヤーとして社会的意義ある価値を創出し、ニーズとシーズを照らし合わせた、付加価値の高い製品提案、ソリューションの開発
- ・ 収益性の高い経営を目指す

■ 各事業の方向性

ソリューション事業

基軸事業を活用し、市場ニーズに合ったソリューションを提供する事業

デザインサービス事業

半導体事業で積み重ねた強味を活かし、常に新しい技術を活用した開発力と設計品質の向上に努め、付加価値を高める事業

半導体事業

成長市場に注力し、安定的に収益を上げていく基盤事業



PALTEKグループの強み



半導体をベースにした営業力・提案力・開発力



無線通信技術



画像処理技術



制御技術



センサ技術

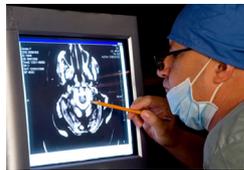


注力技術

AI、データセンター、IoT、5G、ADAS、ビッグデータ、ロボット



産業機器



医療



放送・映像



公共インフラ



車載



中期経営計画（数値目標）

■ 数値目標（2022年度）

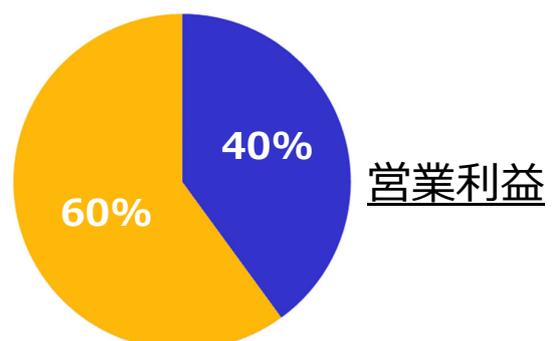
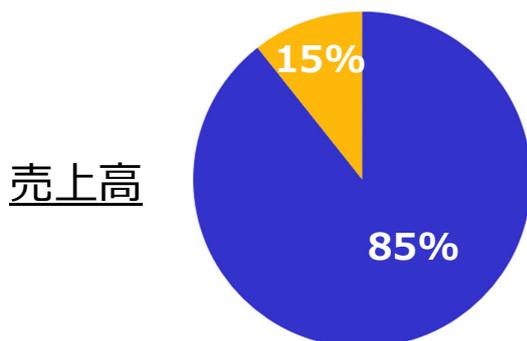
売上高

400億円以上

営業利益率

5%以上

2022年時の売上高/営業利益の構成イメージ



■ 半導体事業

■ デザインサービス事業 + ソリューション事業

基軸事業	半導体事業	<ul style="list-style-type: none"> 産業分野、通信分野などを中心に半導体関連製品を提供 AI活用分野や、IoT、データセンター、車載周辺市場などへの提案力を強化
	デザインサービス事業	<ul style="list-style-type: none"> 培ってきた技術力、設計力をベースに設計受託、ODMを行い、収益性を高める
新規事業 (投資フェーズ)	デザインサービス事業 (モデルベース開発による設計受託)	<ul style="list-style-type: none"> モデルベース開発により車載分野での設計受託案件を拡大し、成長分野で収益性を高める
	ソリューション事業	<ul style="list-style-type: none"> 基軸事業を活用し、社会的ニーズに合ったソリューションを提供し、収益性を高める

【半導体事業【基軸】】 重点施策について

【事業環境】

- AI、ビッグデータ、IoTの活用により半導体市場が拡大
 - さまざまなモノがインターネットに接続され、IoT関連やデータセンター向けの半導体市場が成長
- 車載分野およびその周辺市場は堅調
 - 自動運転、電気自動車(EV)が更に発展

取り組み

- AIを活用した提案力の強化
- IoT、データセンター、車載周辺市場などの成長分野に提案力を強化
(Xilinx、Micron、Microchip、NXP、MPS)

■ 取引先の異動

- 2020年第2四半期より、一部の大手顧客への販売を他代理店に移管

■ 取引形態の変更

- 一部の大手顧客での技術サポートを当社が実施
- ザイリンクス社が新規案件獲得に注力
- 両社で協力し売上高拡大を目指す

ザイリンクス社製品販売の領域の変遷(大手顧客)



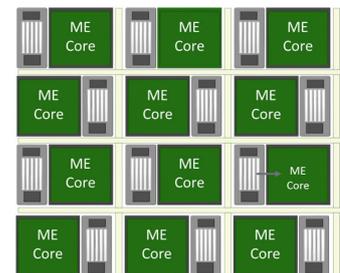
■ 将来業績への影響

- 売上高30億円、営業利益5千万円の減少
(2020年12月期では、売上高25億円、営業利益3千万円の減少)

【FPGAの進化】

- ザイリンクス社は、成長市場に合わせ新製品を随時投入
- 注力分野：AI、データセンター、5G、ADASなど
- ザイリンクス製品のテクノロジーが高度化
FPGA(設計)サポート力の重要性が増す

AI搭載のACAP VERSAL™



FPGA内に数多くのプロセッサが内蔵

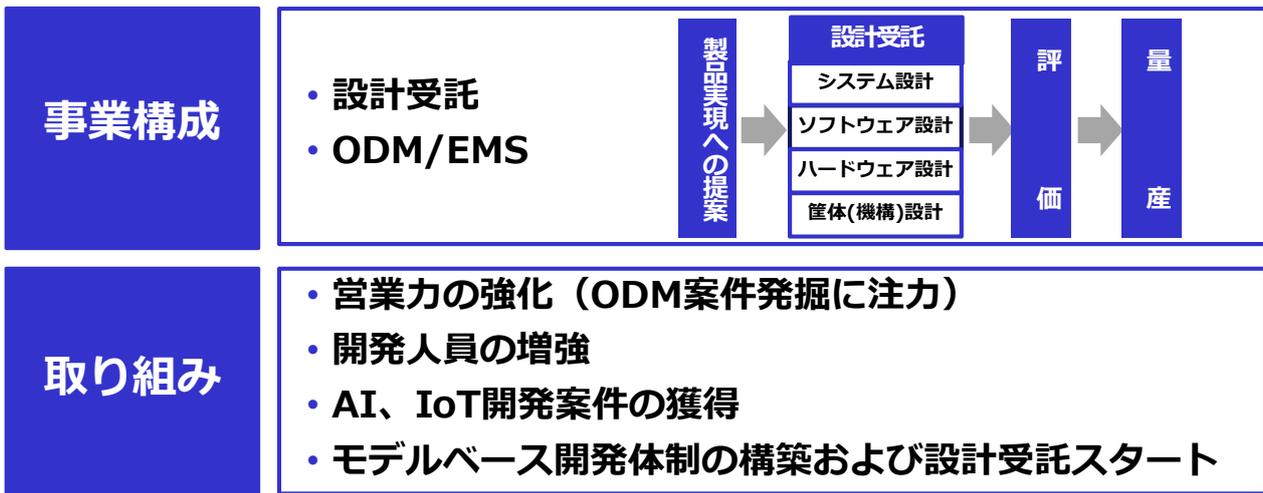
PALTEKの 取り組み

- 深いレベルでの技術サポートを強化
- 顧客製品実現に向けた技術サポートからの提案

【デザインサービス事業【基軸】】 重点施策について

【事業環境】

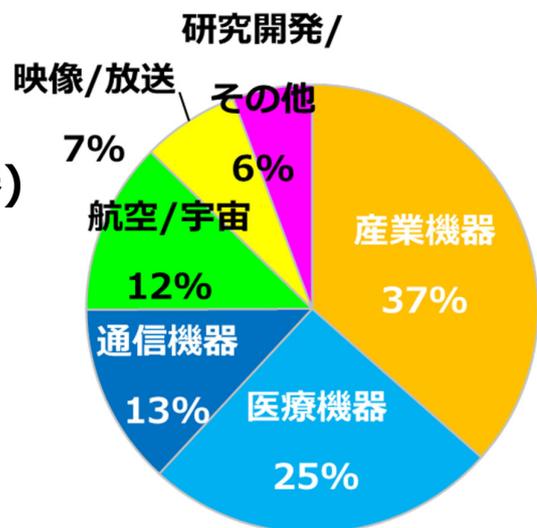
- 機器自体やそれを構成する半導体などが高機能化・高度化し、すべてをお客様のみで開発することが困難
- お客様は社外リソースも活用し、製品リリースの早期化が必要



【デザインサービス事業【基軸】】 設計受託およびODMの状況

- 2019年Q3(累計)では前期と比較し、産業機器、医療機器、航空/宇宙分野向けが増加
- 特に公共インフラ向け(産業機器)のODMが増加
- ODM比率は引き続き約6割で堅調に推移

用途別売上構成（2019年Q3）





【デザインサービス事業【新規】】 モデルベース開発の取り組み

■ ハードウェアエミュレータ「白虎」の拡販

- ・ 車両運動モデル、バッテリーモデルを販売に向けた準備
- ・ 各イベントに参加：各車載メーカーへのプロモーション



<2019年度：出展展示会>

自動車技術展
人とくるまのテクノロジー展
2019 横浜
AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPOSITION 2019 YOKOHAMA

会期：2019年5月22日～24日
会場：パシフィコ横浜

自動車技術展
人とくるまのテクノロジー展
2019 名古屋
AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPOSITION 2019 NAGOYA

会期：2019年7月17日～19日
会場：ポートメッセなごや

第2回 名古屋
オートモティブワールド
クルマの先端技術展

会期：2019年9月18日～20日
会場：ポートメッセなごや

■ モデルのハードウェア化の受託案件獲得へ

■ 技術者の育成、人員確保



【ソリューション事業【新規】】 事業領域の開拓

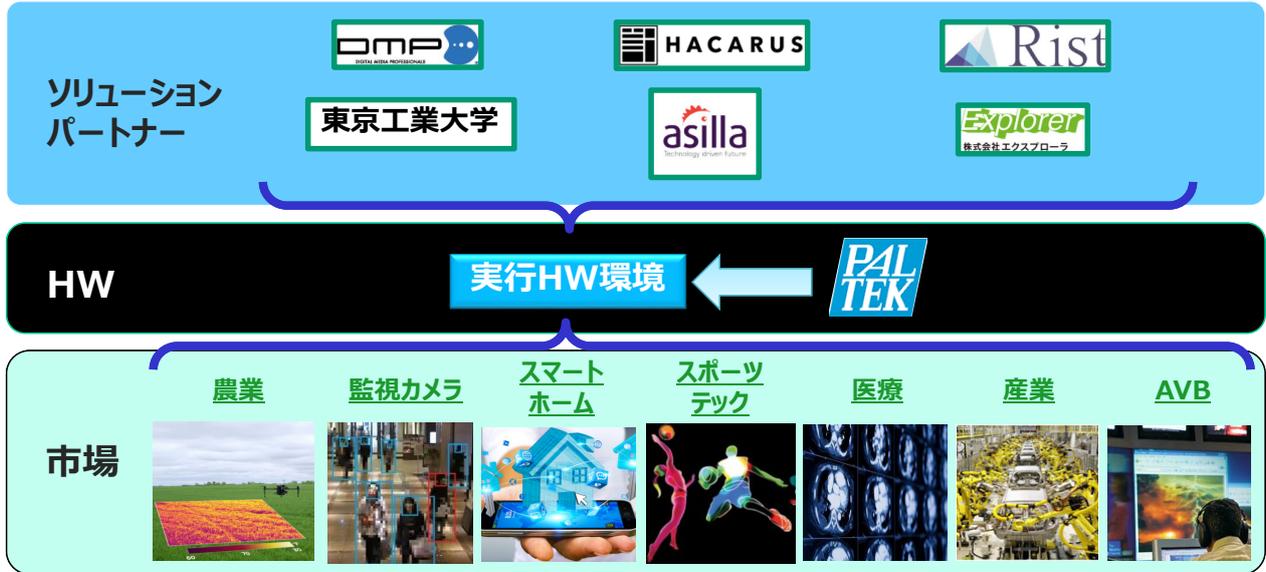
■ ソリューション事業の狙い

- ・ 市場拡大が見込まれる分野に注力したソリューションを発掘・開発
- ・ 将来的にIoTやサービス等の付加価値の可能性のあるソリューションを展開

	産業	映像・放送	医療・介護 ヘルスケア	自動車	物流
既存顧客	工場向け 監視 システム	映像配信 システム	ウェアラブル ロボット 乳幼児 呼吸見守り システム	TPMS 運行管理 システム	梱包用 紙緩衝材 システム ウェアラブル ロボット
新規顧客					

要素技術は、AI、通信、画像処理、センシング

【ソリューション事業 [新規]】 AIソリューションの構築



【提供ソリューション】

- 安全確保
- データの創造から生産性向上
- 未来の予測
- 人の不均一作業の均一化
- 人作業の自動化
- まだ無い市場の創造

【ソリューション事業 [新規]】 AIソリューションの構築

■ 外観検査サービスを提供開始

- 株式会社ハカルスが開発したAIベースの外観検査サービスを提供
- 外観検査装置や自動光学検査装置を補完し、2次検査を省力化
- 数社がトライアル開始



■ AIモジュールの販売をベースに案件拡大

- FPGAベースのAIモジュールによりAI処理をハードウェア化し高速処理を実現



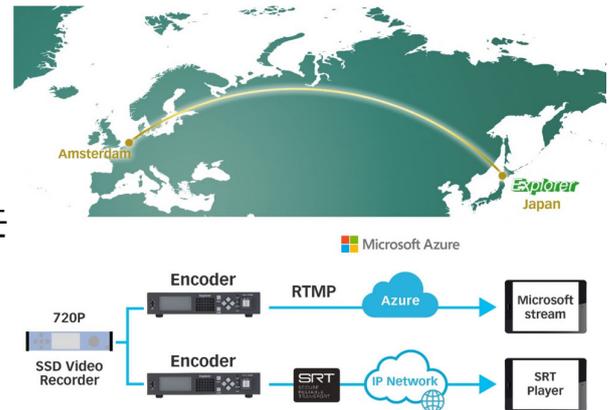
【ソリューション事業 [新規]】 映像配信システムのビジネス進捗①

■ ビジネスの位置づけ

- 映像による情報提供ニーズが高まる中、保有する映像処理に関する技術をベースに、映像配信システムを提供
- 自社製品販売だけでなく、OEM供給や他社製品の提供も行う

■ 国内外の展示会に出展し、プロモーション実施

- 欧州最大の放送機器展「IBC 2019」に出展
 - SRT搭載 H.265/HEVC4K/2Kコーデックシステムを展示
 - 海外販売パートナーの開拓
 - Microsoft Azureによる配信とSRTによる配信映像の比較デモ

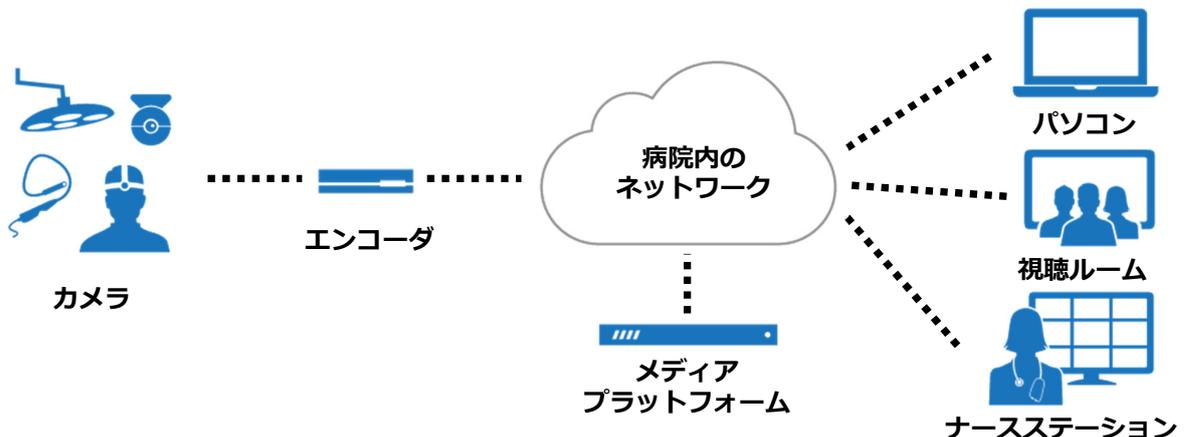


37

【ソリューション事業 [新規]】 映像配信システムのビジネス進捗②

■ 航空/宇宙分野向けに映像配信システムを継続提案

■ 医療機関向けに映像配信システムを提案中



38

■ ビジネスの位置づけ



- 成長すると見込まれる物流分野への事業展開
- 生態系への影響懸念により脱プラスチックが進む中、プラスチック系緩衝材に代わる紙緩衝材活用による物流コスト低減提案
- ストック型ビジネス

■ 「JAPAN PACK 2019」に出展

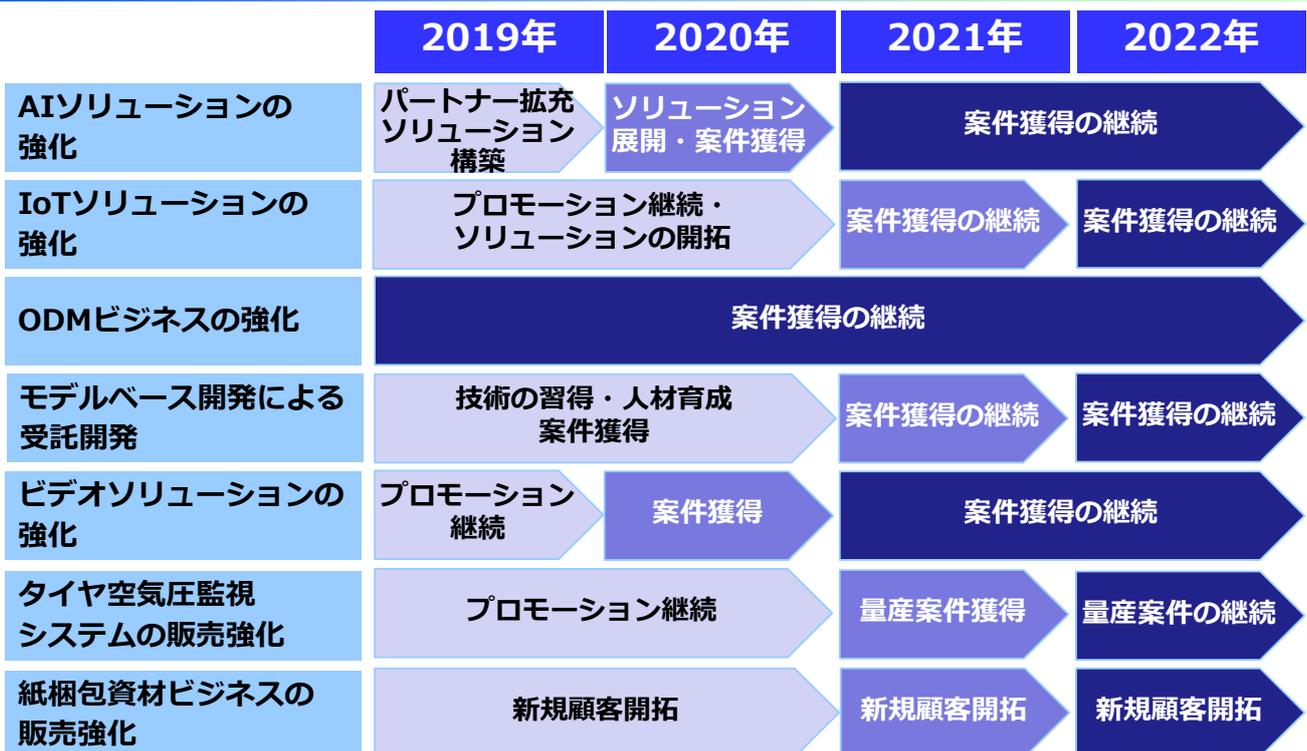
- 開催日時：2019年10月29日～11月1日
- 各物流ニーズに合った紙緩衝材システム展示
- 多くの新規顧客に提案



■ ビジネスの進捗状況（2019年9月末）

- トライアル : 105社（2019年3月末から22社増）
134台（2019年3月末から18台増）
- 採用（累計） : 53社（2019年3月末から10社増）
210台（2019年3月末から42台増）

主な新規事業の収益化へのロードマップ



投資期

黒字転換期

利益成長期

参 考 資 料

© 2019 PALTEK Corporation. All rights reserved.



為替変動に関する影響

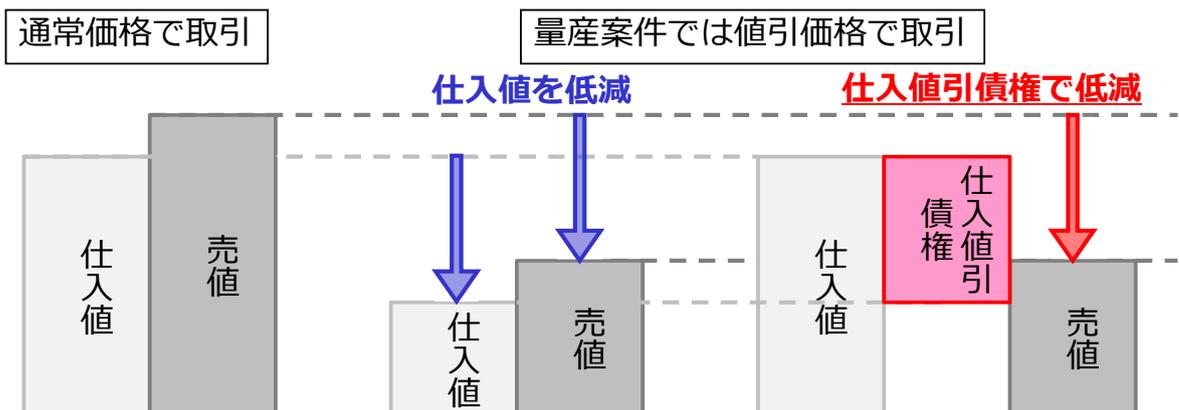
■ 為替変動により当社グループの利益は以下の4点で影響を受ける

- ① 仕入値引ドル建債権の為替変動による影響
- ② 調達在庫の為替変動による影響
- ③ 決済時のドル調達レート変動による影響
- ④ ドル建売掛金入金時のレート変動による影響

為替変動による影響の発生要因①

【仕入値引ドル建債権の為替変動による影響】

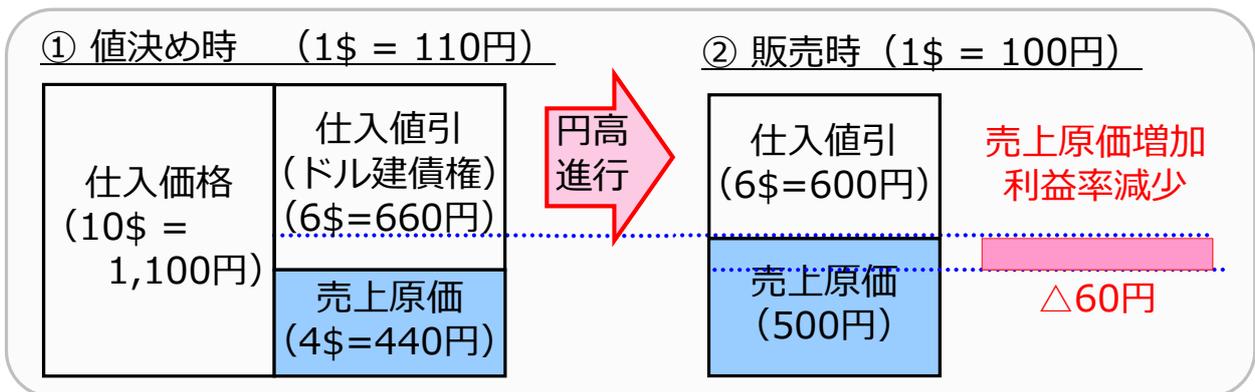
- 当社が仕入先に対して保有する『仕入値引ドル建債権』が、為替レートの変動により評価額が増減することで、業績に大きな影響を与える
- 仕入値引ドル建債権について：
 - ・ 量産案件によっては、通常価格よりも低い価格での販売を要請されることがある
 - ・ その場合、仕入先との間で仕入価格の低減交渉を行う
 - ・ その実現方法は、「仕入値自体の低減」と「仕入値引債権の付与による低減」



急速な円高進行による仕入値引債権の評価額減少

- 仕入値引債権の評価額の増減は、値決め時と販売時の為替レートの差により生じる
- そのため、急速に円高が進行すると、為替レートの差が大きくなるため、仕入値引債権の評価額が大幅に減少
- これにより、売上原価が増加し、売上総利益が減少

例：仕入れ価格10ドルの製品を販売する際の売上原価の変化



45

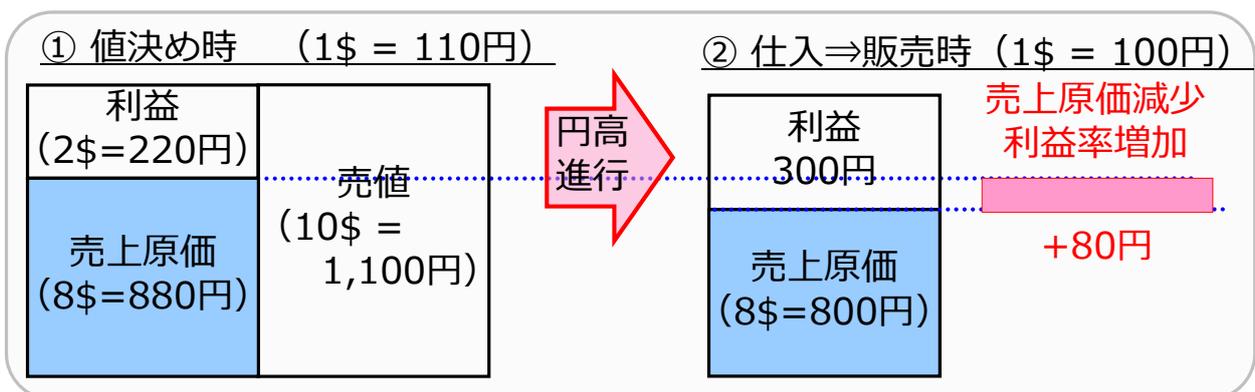
© 2019 PALTEK Corporation. All rights reserved.

為替変動による影響の発生要因②

【調達在庫の為替変動による影響】

- 海外から仕入れたドル建の製品において、為替レートが円高に進行することにより、売上原価が減少し、売上総利益は増加

例：仕入れ価格10ドルの製品を販売する際の売上原価の変化



46

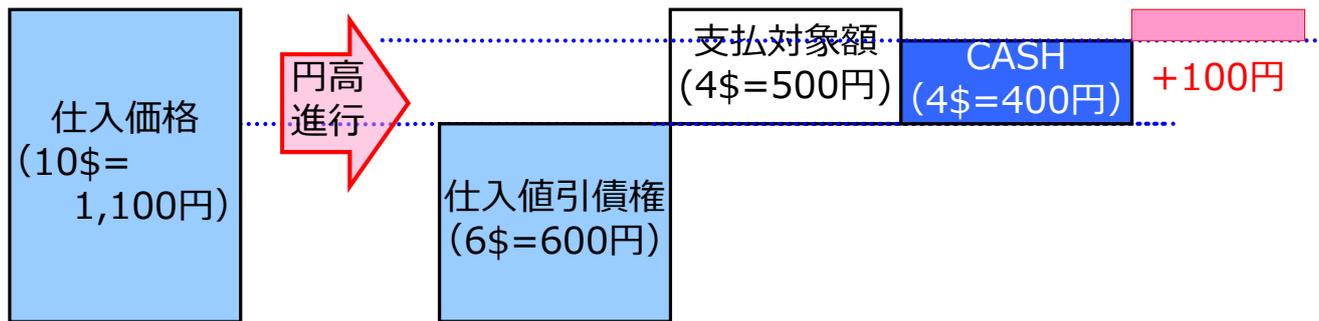
© 2019 PALTEK Corporation. All rights reserved.

為替変動による影響の発生要因③

【決済時のドル調達レート変動による影響】

- 支払を行う際に円高に進行していた場合、ドルを調達する金額が少なくなるため、決済差額が生まれ、為替差益を計上することとなる
- 一方、円安に進行した場合は、為替差損を計上することとなる

① 仕入時 (1\$ = 110円) ② 販売・支払時 (1\$ = 100円)



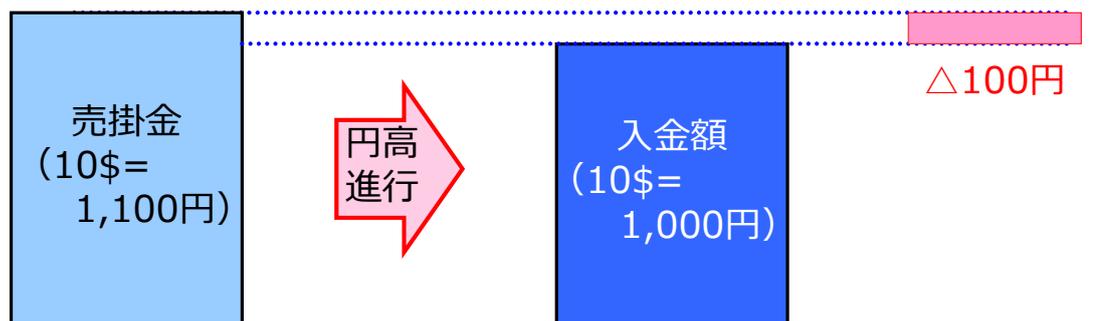
為替変動による影響の発生要因④

【ドル建売掛金入金時のレート変動による影響】

- ドル建売掛金の入金がある場合には、円高に進行するとマイナス、円安に進行するとプラスの影響が発生する（営業外の為替差損益）
- 当社はこのリスクを限定的にするために、為替予約を行っている

① 販売時 (1\$ = 110円)

② 入金時 (1\$ = 100円)



為替変動の影響額（2019年第3四半期）

■ 売上総利益への影響額

- Q2の評価レートからQ3評価レートに関して円高に進行したことにより、為替変動の影響額はマイナス方向に

(単位：百万円)	18Q1	18Q2	18Q3	18Q4	19Q1	19Q2	19Q3
為替レートの変動（円）	113→ 106	106→ (111)→ 109	111→ 113	113→ 110	108→ 110	110→ (112)→ 107	108→ (106)→ 108
為替変動の影響（売上総利益）	-148	3	52	59	-63	-124	-108
仕入値引債権の評価額変動の影響	-338	-8	307	341	-396	60	-542
調達在庫の為替レート変動の影響	189	11	-256	-280	333	-183	434

■ 営業外損益への影響額（期末評価替の影響は含まず）

- 買掛金支払時のレート変動の影響は、円高進行のためプラスに（売上総利益への影響額と相殺関係に）

(単位：百万円)	18Q1	18Q2	18Q3	18Q4	19Q1	19Q2	19Q3
買掛金支払時のレート変動の影響（営業外）	88	-19	-89	-34	-15	122	64

- 売掛金受取時のレート変動の影響額は、円高方向に進行したことによりマイナス方向に

(単位：百万円)	18Q1	18Q2	18Q3	18Q4	19Q1	19Q2	19Q3
売掛金受取時のレート変動の影響（営業外）	-74	-25	-8	20	-42	-49	-61

2019年12月期 製品別業績予想

(百万円)	2018年12月期 実績			2019年12月期 業績予想			通期増減	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額	増減率
半導体	14,681	13,855	28,536	13,473	12,976	26,450	△2,086	△7.3%
FPGA	6,025	5,944	11,969	6,938	5,761	12,700	730	6.1%
特定用途IC	2,109	2,262	4,372	2,421	2,078	4,500	127	2.9%
汎用IC	1,871	1,842	3,713	1,542	1,658	3,200	△513	△13.8%
アナログ	1,133	1,237	2,371	969	1,080	2,050	△321	△13.5%
メモリ	3,541	2,568	6,110	1,601	2,398	4,000	△2,110	△34.5%
デザインサービス	814	985	1,799	867	1,332	2,200	400	22.2%
ソリューション	89	144	233	453	396	860	616	264.1%
売上高合計	15,585	14,984	30,569	14,794	14,705	29,500	△1,069	△3.5%
営業利益	381	176	558	61	188	250	△308	△55.2%

開示区分	内容説明
半導体事業	半導体及び関連製品の販売、技術支援
FPGA	ザイリンクス社のFPGAを中心とするソリューション
特定用途IC	特定用途に特化した半導体を中心とするソリューション (例：通信向け、インタフェース向け、携帯端末向け等)
汎用IC	NXPセミコンダクターズ社、マイクロチップテクノロジー社等の汎用ICを中心とするソリューション
アナログ	アナログ半導体を中心とするソリューション
メモリ	マイクロンテクノロジー社等のメモリを中心とするソリューション
デザインサービス事業	受託開発、ODM/EMS/OEM
ソリューション事業	最終製品レベルでのソリューション提案を実施 自社製品（ハードウェア、ソフトウェア、システム）の 開発・販売

以下の担当までお問い合わせ下さい。

株式会社PALTEK

柴崎 由記 (IR担当)

〒222-0033

横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエアビル

TEL : 045-477-2072

FAX : 045-477-2012

E-mail : ir@paltek.co.jp